

<<电子装配工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子装配工艺>>

13位ISBN编号：9787505382206

10位ISBN编号：7505382209

出版时间：2003-4

出版时间：电子工业出版社

作者：杨清学 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子装配工艺>>

内容概要

本书内容包括：常用技术文件及整机装配工艺过程、常用电子材料、常用电子元器件与仪器、电子装配与连接工艺、装配准备工艺基础、电子部件装配工艺、电子整机总装与调试工艺、检验与包装工艺等。

章后有小结和习题。

本书既强调基础，又力求体现新知识、新技术、新工艺，内容与国家职业技能鉴定规范相结合，注重实践性和学生技能的培养。

本书可作为高职电子与信息专业教材，也可作为有关工程技术人员的参考用书。

书籍目录

第1章 常用技术文件及整机装配工艺过程 1.1 概述 1.2 常用技术文件 1.3 电子整机装配工艺过程
本章小结 习题1 第2章 常用电子材料 2.1 线材 2.2 绝缘材料 2.3 印制电路板 2.4 磁性材料
2.5 辅助材料 本章小结 习题2 第3章 常用电子元器件与仪器 3.1 电阻器 3.2 电容器 3.3 电
感元件 3.4 半导体器件 3.5 集成电路IC 3.6 电声器件及磁头 3.7 其他元器件 3.8 常用仪器、
仪表 本章小结 习题3 第4章 电子产品安装和焊接工艺 4.1 常用工具 4.2 常用设备 4.3 焊接工
艺 4.4 表面安装技术SMT 4.5 其他连接工艺 本章小结 习题4 第5章 装配准备工艺基础 5.1
导线加工工艺 5.2 元器件引线成形 5.3 线扎制作 本章小结 习题5 第6章 电子部件装配工艺
6.1 印制电路板的组装机工艺 6.2 面板、机壳装配工艺 6.3 散热件、屏蔽装置的装配工艺 本章小
结 习题6 第7章 电子整机总装与调试工艺 7.1 电子整机总装工艺 7.2 整机调试工艺 本章小结
习题7 第8章 检验与包装工艺 8.1 检验 8.2 包装工艺 本章小结 习题8 附录A 常用电阻器、电
容器的型号命名 附录B ISO 9000系列质量标准 附录C 半导体器件的型号命名 附录D 半导体集成电路
的型号命名 参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>